

Transfer Molding System

Model YPM1080-SP



**Transfer molding system utilizing
high fluidity resin realizing high quality molding for substrates**

高流動樹脂成形の高品質化を実現する 基板専用トランスファモールド装置

製品情報



日本語

- シンプルな金型構造により、容易な品種交換とコストダウンを実現
- MUF成形にも対応した構造を採用
- エッジゲート方式を採用し、高流動樹脂での成形時に樹脂漏れを防止
- プレスモジュールの増減による生産数量の変化への対応



SPECIFICATION

Items		Unit	Description			
モデル		—	YPM1080-SP			
ワークタイプ		—	基板			
ワークサイズ	長さ	mm	150—300			
	幅	mm	75—100			
樹脂	径	mm	φ 14, 16			
	長さ	mm	15.4—35.0			
マシンタイム		sec	Approximately 40 (45*)			
外形寸法	プレス数	module	1	2	3	4
	幅	mm	2,540	3,220	3,900	4,580
	奥行き	mm	2,000	2,000	2,000	2,000
	高さ	mm	1,980	1,980	1,980	1,980
重量		ton	6.0 (6.1*)	9.1 (9.3*)	12.2 (12.5*)	15.3 (15.7*)
成形取り数		workpiece	2	4	6	8
インพุットマガジンスペース		mm	440			
アウトพุットマガジンスペース (スリットマガジン仕様)		mm	440			
クランプ出力		kN／(tf)	98.0—784.0／10.0—80.0			
トランスファ出力		kN／(tf)	3.92—49.0／0.4—5.0 (2圧設定)			
品種切替え方式		—	キット交換式			
搭載可能金型		—	YPM1080-SP 専用金型			

- ・上記数値は当社標準機の場合です。
- ・改良のため仕様を変更する事があります。
- ・特殊システム仕様についてはご相談ください。
- ・エッジゲート方式の場合はワークサイズ・樹脂をご相談ください。
- ・*の値はリリースフィルム仕様の場合です。



本社

〒601-8105
京都府京都市南区上鳥羽上調子町 5 番地

お問い合わせ先



TOWA (当社のハウスマーク)、 はTOWA株式会社の商標または登録商標です。

海外販売拠点

中国
TOWA (Shanghai) Co., Ltd.
台湾
TOWA Taiwan Co., Ltd.
韓国
TOWA Korea Co., Ltd.
シンガポール
TOWA Asia-Pacific Pte. Ltd.
マレーシア
TOWA Malaysia Sales & Services Sdn. Bhd.
タイ
TOWA THAI COMPANY LIMITED

フィリピン
TOWA Semiconductor Equipment Philippines Corp.
インド
TOWA SEMICONDUCTOR INDIA PRIVATE LIMITED
ドイツ
TOWA Europe GmbH
オランダ
TOWA Europe B.V.
アメリカ
TOWA USA Corporation